

レーザー切断・穴あけ加工装置(LTS社製LDS D-3000M)

製造元	Laser Total Solution Ltd.
仕様	波長 355 nm, パルス幅: 40 ns
保有部署	材料化学専攻 無機構造化学分野
設置場所	桂・イノベーションプラザ棟・207室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/f6rs2o/
注意事項等	利用申請前に利用の概略を下記連絡先に必ずお知らせいただき承認を得てください。
連絡先	材料化学専攻 無機構造化学分野 助教 清水雅弘 075-383-2463 shimizu.masahiro.3m (at) kyoto-u.ac.jp http://func.mc.kyoto-u.ac.jp/ 利用申請前に利用の概略をこちら宛に必ずお知らせいただき承認を得てください。
キーワード	穴あけ、マーキング、表面処理
機器コード	0000110004
自由記入欄	紫外ナノ秒レーザーを用いた極薄板の穴あけやマーキングなどの表面処理が可能

